

Japan Patent Office

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: October 31, 2002

Application Number: Japanese Patent Application  
No.2002-318249

[ST.10/C]: [JP2002-318249]

Applicant(s): RICOH COMPANY, LTD.

July 18, 2003

Commissioner,  
Japan Patent Office

Yasuo Imai (Seal)

Certificate No.2003-3057742

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 2 年 1 0 月 3 1 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 2 - 3 1 8 2 4 9  
[ST. 10/C]: [ J P 2 0 0 2 - 3 1 8 2 4 9 ]

出 願 人  
Applicant(s): 株式会社リコー

2 0 0 3 年 7 月 1 8 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫

出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 5 7 7 4 2

【書類名】 特許願

【整理番号】 0208489

【提出日】 平成14年10月31日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G01C 17/32

【発明の名称】 M I センサ、M I センサ用の I C チップおよびその M I  
センサを備えた電子装置

【請求項の数】 15

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 木村 岳史

【特許出願人】

    【識別番号】 000006747

    【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代理人】

    【識別番号】 100070150

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 002989

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 MI センサ、MI センサ用の IC チップおよびその MI センサを備えた電子装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 外部磁場を検知する MI 素子からの検知信号が供給され、四角形状の MI センサ用の IC チップであって、

前記 MI 素子を接続する MI 素子接続用電極と、

パルス状の信号によって制御され、前記 MI 素子に MI 素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、

前記電流供給用スイッチング手段に電源電圧を供給する第 1 の電源電圧供給用電極とを有し、

前記 MI 素子接続用電極が当該 IC チップの第 1 の辺の近傍に設けられると共に、前記第 1 の電源電圧供給用電極が前記第 1 の辺と反対側の第 2 の辺の近傍に設けられることを特徴とする MI センサ用の IC チップ。

【請求項 2】 1 つの MI 素子に接続され、

前記 MI 素子接続用電極と、電流供給用スイッチング手段と、第 1 の電源電圧供給用電極とがほぼ直線状に配置されていることを特徴とする請求項 1 記載の MI センサ用の IC チップ。

【請求項 3】 MI 素子からの検知信号が供給される検知信号用電極と、

前記検知信号用電極を介して前記検知信号が供給され、該検知信号を処理する信号処理手段と、

前記信号処理手段に電源電圧を供給する第 2 の電源電圧供給用電極とを有し、

前記検知信号用電極が前記第 1 の辺の近傍に設けられると共に、前記第 2 の電源電圧供給用電極が前記第 2 の辺の近傍に設けられることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の MI センサ用の IC チップ。

【請求項 4】 前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給されることを特徴とする請求項 3 記載の MI センサ用の IC チップ。

【請求項 5】 前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異な

る接地線が接続されていることを特徴とする請求項 3 または 4 記載の M I センサ用の I C チップ。

【請求項 6】 外部磁場を検知する M I 素子からの検知信号が供給され、四角形状の M I センサ用の I C チップであって、

パルス状の信号によって制御され、前記 M I 素子に M I 素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、

前記 M I 素子からの検知信号が供給され該検知信号を処理する信号処理手段とを有し、

前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給されることを特徴とする M I センサ用の I C チップ。

【請求項 7】 前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されていることを特徴とする請求項 6 記載の M I センサ用の I C チップ。

【請求項 8】 外部磁場を検知する M I 素子と、前記 M I 素子からの検知信号が供給される四角形状の I C チップと、よりなる M I センサであって、

前記 I C チップは、前記 M I 素子を接続する M I 素子接続用電極と、パルス状の信号によって制御され、前記 M I 素子に M I 素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、

前記電流供給用スイッチング手段に電源電圧を供給する第 1 の電源電圧供給用電極とを有し、

前記 M I 素子接続用電極が M I 素子に面する前記 I C チップの第 1 の辺の近傍に設けられると共に、前記第 1 の電源電圧供給用電極が前記第 1 の辺と反対側の第 2 の辺の近傍に設けられることを特徴とする M I センサ。

【請求項 9】 1 つの M I 素子に接続され、

前記 M I 素子接続用電極と、電流供給用スイッチング手段と、第 1 の電源電圧供給用電極とがほぼ直線状に配置されていることを特徴とする請求項 8 記載の M I センサ。

【請求項 1 0】 M I 素子からの検知信号が供給される検知信号用電極と、前記検知信号用電極を介して前記検知信号が供給され、該検知信号を処理する

信号処理手段と、

前記信号処理手段に電源電圧を供給する第2の電源電圧供給用電極とを有し、  
前記検知信号用電極が前記第1の辺の近傍に設けられると共に、前記第2の電源電圧供給用電極が前記第2の辺の近傍に設けられることを特徴とする請求項9記載のMIセンサ。

【請求項11】 前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給されることを特徴とする請求項10記載のMIセンサ。

【請求項12】 前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されていることを特徴とする請求項10または11記載のMIセンサ。

【請求項13】 外部磁場を検知するMI素子と、前記MI素子からの検知信号が供給される四角形状のICチップと、よりなるMIセンサであって、

前記ICチップは、前記MI素子にMI素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、MI素子からの検知信号が供給され該検知信号を処理する信号処理手段とを有し、

前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給されることを特徴とするMIセンサ。

【請求項14】 前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されていることを特徴とする請求項13記載のMIセンサ。

【請求項15】 請求項8～14のうち、いずれか一項記載のMIセンサを備えた電子装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、微弱な磁場を検知可能なMI素子を備えたMIセンサ、そのMIセンサの主要部であるICチップ、さらにそのMIセンサを備えた電子装置に関する。

【0002】

**【従来の技術】**

近年、磁気記録分野における磁気記録密度の向上の原動力として、再生用磁気ヘッドの感磁素子に磁気抵抗効果型素子（MR素子）の採用が挙げられる。さらにMR素子は感度を向上させた巨大磁気抵抗効果を利用したGMR素子へと発展され、磁場検出感度の飛躍的向上が達成されている。GMR素子は外部からの印可された磁場の方向に応じて軟磁性膜であるフリー層の磁化方向が変化し、磁化固定層の磁化とのなす角度に応じて、これらの層を流れる電子のスピンが通過可能な量に変化する現象すなわちスピンエレクトロニクス現象を利用したものである。GMR素子は10  $\mu$ mにまで小型化可能という特長を有しているが、磁場検出限界はおおよそ0.01 Oeであり、更なる感度向上の検討が行われている。

**【0003】**

一方、磁気センサとして、磁気インピーダンス効果（MI効果）を利用したMI素子が提案されている。MI素子は、軟磁性体よりなるアモルファスワイヤに高周波あるいはパルス状の電流を印加して表皮効果を発生させ、アモルファスワイヤの長手方向に印可されている外部磁場との作用で、アモルファスワイヤの透磁率の変化によりインピーダンスが変化し、アモルファスワイヤに巻回されている検知コイルに検知信号として誘導される現象を利用して外部磁場を検出するものである。MI素子の特長は、（1）磁場検出限界が1  $\mu$ Oeであり高感度であること、（2）短パルス電流を使用するので低消費電力であることである。MI素子はこれらの特長を生かして多方面の用途に実用化が検討されている。

**【0004】****【特許文献1】**

特開平6-176930号公報

**【0005】****【発明が解決しようとする課題】**

ところで、MI素子は、アモルファスワイヤに印可するパルス状の電流の電流値が高い程、より理想的な方形波である程、磁場の検出感度が向上する。しかし、かかる電流は比較的大電流の方形波ゆえノイズが発生し、信号対雑音比を低下

させてしまい、逆に検出感度を低下させるという問題を生ずる。特にMI素子にパルス状の電流を供給する電子回路をICチップ化すると、高密度に集積されているのでノイズの影響を受け易い。例えば、パルス状の電流に起因する電磁波の放射、あるいはICチップの電源線又は接地線を介して、MI素子からの検知信号を処理する検知回路等の信号に重畳され、実際の検知信号に重畳され、精度良く磁場を検出できないという問題を生ずる。

#### 【0006】

他方、かかるノイズの影響を回避するためにICチップの大きさを拡大して、かかるノイズの影響を低減することも可能であるがMIセンサの小型化が困難になる。

#### 【0007】

したがって、本発明は上記の問題に鑑みてなされたもので、本発明の目的は、小型化かつ信号対雑音比の向上可能なMIセンサ、MIセンサ用のICチップおよびそのMIセンサを備えた電子装置を提供することである。

#### 【0008】

##### 【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の如く、外部磁場を検知するMI素子からの検知信号が供給され、四角形状のMIセンサ用のICチップであって、前記MI素子を接続するMI素子接続用電極と、パルス状の信号によって制御され、前記MI素子にMI素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、前記電流供給用スイッチング手段に電源電圧を供給する第1の電源電圧供給用電極とを有し、前記MI素子接続用電極が当該ICチップの第1の辺の近傍に設けられると共に、前記第1の電源電圧供給用電極が前記第1の辺と反対側の第2の辺の近傍に設けられるMIセンサ用のICチップが提供される。

#### 【0009】

請求項1記載の発明によれば、励磁電流はパルス状であるため高周波のノイズを電磁波あるいはICチップ内の近接する配線に誘導される形で、他の回路に影響を及ぼす。ICチップの第1の辺の近傍に電流供給用スイッチング手段から供給される励磁電流をICチップより取り出してMI素子に供給するためのMI素



子接続用電極が設けられ、第 1 の辺の反対側の第 2 の辺の近傍に電流供給用スイッチング手段に電源電圧を供給する第 1 の電源電圧供給用電極が設けられており、励磁電流が流れる M I 素子接続用電極と第 1 の電源電圧供給用電極とが離隔されているので、上記ノイズが第 1 の電源電圧供給用電極に接続された他の回路の信号に重畳することを抑制することができ、磁場検出の信号対雑音比を向上することができる。

#### 【 0 0 1 0 】

請求項 2 に記載の如く、請求項 1 記載の M I センサ用の I C チップにおいて、1 つの M I 素子に接続され、前記 M I 素子接続用電極と、電流供給用スイッチング手段と、第 1 の電源電圧供給用電極とがほぼ直線状に配置されている。

#### 【 0 0 1 1 】

請求項 2 記載の発明によれば、I C チップの第 1 の辺の近傍に M I 素子接続用電極が設けられ、第 1 の辺の反対側の第 2 の辺の第 1 の電源電圧供給用電極が設けられ、さらに、M I 素子接続用電極と電流供給用スイッチング手段と第 1 の電源電圧供給用電極とがほぼ直線状に配置されている。したがって、これらの励磁電流を生成・供給する回路及び電極を I C チップ内でブロック化することができるので、I C チップ内の他の回路に与えるノイズの影響を抑制することができる。また、I C チップの配置効率及び面積効率を向上することができる。

#### 【 0 0 1 2 】

請求項 3 に記載の如く、請求項 1 または 2 記載の M I センサ用の I C チップにおいて、M I 素子からの検知信号が供給される検知信号用電極と、前記検知信号用電極を介して前記検知信号が供給され、該検知信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段に電源電圧を供給する第 2 の電源電圧供給用電極とを有し、前記検知信号用電極が前記第 1 の辺の近傍に設けられると共に、前記第 2 の電源電圧供給用電極が前記第 2 の辺の近傍に設けられる。

#### 【 0 0 1 3 】

請求項 3 記載の発明によれば、信号処理手段に接続される電源電圧が第 2 の電源電圧供給用電極を介して供給されている。したがって、励磁電流によりノイズが電源線を介して伝導することを防止し、かかるノイズが信号処理手段を流れる

信号に重畳されることをさらに抑制できる。その結果、磁場検出の信号対雑音比を向上することができる。

【0 0 1 4】

また、第1の辺にM I 素子接続用電極に加え検知信号用電極が配置されている。これらの電極はM I 素子に接続するためのもので、1つの辺に配置することで、M I 素子への接続を容易化し、その配線長を短小化することが可能である。一方、第1の辺とは反対側の第2の辺に、第1の電源電圧供給用電極と第2の電源電圧供給用電極とが配置されているので、I Cチップが実装されるケース等への配線を容易化し、さらにI Cチップの配置効率及び面積効率を向上することができる。

【0 0 1 5】

請求項4に記載の如く、請求項3記載のM I センサ用のI Cチップにおいて、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給される。

【0 0 1 6】

請求項4記載の発明によれば、電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には異なる電源から供給され、電源電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが電源線を介して伝導することをより完全に防止できる。

【0 0 1 7】

請求項5に記載の如く、請求項3または4記載のM I センサ用のI Cチップにおいて、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されている。

【0 0 1 8】

請求項5記載の発明によれば、接地電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが接地線を介して伝導することをより完全に防止できる。

【0 0 1 9】

請求項6に記載の如く、外部磁場を検知するM I 素子からの検知信号が供給され、四角形状のM I センサ用のI Cチップであって、パルス状の信号によって制御され、前記M I 素子にM I 素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給

する電流供給用スイッチング手段と、M I 素子からの検知信号が供給され該検知信号を処理する信号処理手段とを有し、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給されるM I センサ用の I C チップが提供される。

#### 【 0 0 2 0 】

請求項 6 記載の発明によれば、電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には異なる電源から供給され、電源電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが電源線を介して伝導することをより完全に防止できる。

#### 【 0 0 2 1 】

請求項 7 に記載の如く、請求項 6 記載のM I センサ用の I C チップにおいて、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されている。

#### 【 0 0 2 2 】

請求項 7 記載の発明によれば、接地電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが接地線を介して伝導することをより完全に防止できる。

#### 【 0 0 2 3 】

請求項 8 に記載の如く、外部磁場を検知するM I 素子と、前記M I 素子からの検知信号が供給される四角形状の I C チップと、よりなるM I センサであって、前記 I C チップは、前記M I 素子を接続するM I 素子接続用電極と、パルス状の信号によって制御され、前記M I 素子にM I 素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、前記電流供給用スイッチング手段に電源電圧を供給する第 1 の電源電圧供給用電極とを有し、前記M I 素子接続用電極がM I 素子に面する前記 I C チップの第 1 の辺の近傍に設けられると共に、前記第 1 の電源電圧供給用電極が前記第 1 の辺と反対側の第 2 の辺の近傍に設けられるM I センサが提供される。

#### 【 0 0 2 4 】

請求項 8 記載の発明によれば、M I 素子に面する第 1 の辺の近傍に電流供給用スイッチング手段から供給される励磁電流を I C チップより取り出してM I 素子に供給するためのM I 素子接続用電極が設けられ、第 1 の辺の反対側の第 2 の辺

の近傍に電流供給用スイッチング手段に電源電圧を供給する第 1 の電源電圧供給用電極が設けられており、励磁電流が流れる M I 素子接続用電極と第 1 の電源電圧供給用電極とが離隔されているので、励磁電流によるノイズが第 1 の電源電圧供給用電極に接続された他の回路の信号に重畳することを抑制することができ、M I センサの磁場検出の信号対雑音比を向上することができる。

#### 【 0 0 2 5 】

請求項 9 に記載の如く、請求項 8 記載の M I センサにおいて、1 つの M I 素子に接続され、前記 M I 素子接続用電極と、電流供給用スイッチング手段と、第 1 の電源電圧供給用電極とがほぼ直線状に配置されている。

#### 【 0 0 2 6 】

請求項 9 記載の発明によれば、M I 素子に面する第 1 の辺の近傍に M I 素子接続用電極が設けられ、第 1 の辺の反対側の第 2 の辺の第 1 の電源電圧供給用電極が設けられ、さらに、M I 素子接続用電極と電流供給用スイッチング手段と第 1 の電源電圧供給用電極とがほぼ直線状に配置されている。したがって、M I 素子と M I 素子接続用電極との距離を短小化してノイズの放射を抑制することができると共に、励磁電流を生成・供給する回路及び電極を I C チップ内でブロック化することができるので I C チップ内の他の回路に与えるノイズの影響を抑制することができる。その結果、M I センサの磁場検出の信号対雑音比を向上することができる。

#### 【 0 0 2 7 】

請求項 1 0 に記載の如く、請求項 9 記載の M I センサにおいて、M I 素子からの検知信号が供給される検知信号用電極と、前記検知信号用電極を介して前記検知信号が供給され、該検知信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段に電源電圧を供給する第 2 の電源電圧供給用電極とを有し、前記検知信号用電極が前記第 1 の辺の近傍に設けられると共に、前記第 2 の電源電圧供給用電極が前記第 2 の辺の近傍に設けられる。

#### 【 0 0 2 8 】

請求項 1 0 記載の発明によれば、M I 素子に面する第 1 の辺に M I 素子接続用電極に加え検知信号用電極が配置されている。したがって、M I 素子への接続を

容易化し、その配線長を短小化することが可能であるので、励磁電流により放射されたノイズの影響を抑制することができる。一方、第1の辺とは反対側の第2の辺に、第1の電源電圧供給用電極と第2の電源電圧供給用電極とが配置されているので、ICチップが実装されるケース等への配線を容易化し、さらにICチップの配置効率及び面積効率を向上することができるのでMIセンサを小型化することができる。

#### 【0029】

請求項11に記載の如く、請求項10記載のMIセンサにおいて、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給される。

#### 【0030】

請求項11記載の発明によれば、電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には異なる電源から供給され、電源電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが電源線を介して伝導することをより完全に防止できる。

#### 【0031】

請求項12に記載の如く、請求項10または11記載のMIセンサにおいて、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されている。

#### 【0032】

請求項12記載の発明によれば、接地電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが接地線を介して伝導することをより完全に防止できる。

#### 【0033】

請求項13に記載の如く、外部磁場を検知するMI素子と、前記MI素子からの検知信号が供給される四角形状のICチップと、よりなるMIセンサであって、前記ICチップは、前記MI素子にMI素子接続用電極を介してパルス状の励磁電流を供給する電流供給用スイッチング手段と、MI素子からの検知信号が供給され該検知信号を処理する信号処理手段とを有し、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には、異なる電源線を介して電源電圧が供給されるMIセンサが提供される。

## 【0034】

請求項13記載の発明によれば、電流供給用スイッチング手段と信号処理手段には異なる電源から供給され、電源電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが電源線を介して伝導することをより完全に防止できる。

## 【0035】

請求項14に記載の如く、請求項13記載のMIセンサにおいて、前記電流供給用スイッチング手段と信号処理手段とは、異なる接地線が接続されている。

## 【0036】

請求項14記載の発明によれば、接地電位が異なっているので、励磁電流によるノイズが接地線を介して伝導することをより完全に防止できる。

## 【0037】

請求項15に記載の如く、請求項8～14のうち、いずれか一項記載のMIセンサを備えた電子装置が提供される。

## 【0038】

請求項15記載の発明によれば、請求項8～14のいずれかのMIセンサを備えているので、電子装置の小型化が可能であると共に磁場検出の信号対雑音比の向上が可能である。

## 【0039】

## 【発明の実施の形態】

以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。

## 【0040】

## (第1の実施の形態)

図1は、本発明の実施の形態のMIセンサの斜視図である。図1を参照するに、本実施の形態のMIセンサ10は、セラミック、ガラス、プラスチック、シリコン等よりなるケース11と、ケース11の主面と平行にケース11内に配設された1つの磁気インピーダンス素子（以下「MI素子」と呼ぶ。）12と、MI素子12と接続されケース11内に配設されたICチップ13などにより構成されている。このMIセンサ10は、ICチップ13より励磁電流がMI素子12に供給され、磁気インピーダンス効果により外部磁場の大きさに対応した検知信

号がMI素子12に誘導され、ICチップ13がその検知信号を処理して外部磁場の大きさに対応した出力信号を出力するものである。

#### 【0041】

ケース11には、中心にICチップ13を収納する四角形の凹部が形成されており、またMI素子12が収納される長さ約4mm、幅数mm程度の凹部が形成されている。また、周辺部の上面にはケース電極14が設けられ、ワイヤ15などによりICチップ13との接続や、外部との信号の送受信を行う端子に接続されるようになっている。

#### 【0042】

ICチップ13は後述する回路を有するCMOSまたはバイポーラIC等により構成されている。ICチップ13の表面のMI素子12側の辺の近傍には、MI素子12との接続をするための励磁電流用电極16、励磁電流用グランド電極16G、及び検知信号用电極17が設けられている。また、ICチップ13の表面のMI素子12とは反対側の辺の近傍には、電源電圧が供給される電源電極18や、出力信号を外部のMPU等に供給するための出力用电極20、接地電位のためのグランド電極19が設けられている。ICチップ13は、励磁電流用电極16を介してMI素子12のアモルファスワイヤ（図2において示す）にパルス状の励磁電流を供給し、また、検知コイル（図2において示す）に誘導される外部磁場の大きさに対応する検知信号が検知信号用电極17を介して供給され、後述する回路により外部磁場に相当する検出信号が出力される。

#### 【0043】

図2は、MI素子の一例を示す斜視図である。MI素子12は、アモルファスワイヤ41と、そのアモルファスワイヤ41を巻回するように形成された検知コイル42と、アモルファスワイヤ41に接続されICチップ13より励磁電流を供給するための端子43などにより構成され、例えばおおよそ長さ4mm、幅1mm、高さ0.3mmの形状を有する。MI素子12は、磁気インピーダンス効果により、外部磁場のアモルファスワイヤの長手方向の成分の大きさを検出することが可能である。すなわち、図1に示すMI素子12の長手方向であるY方向の磁場成分のみを検出可能である。

## 【0044】

具体的には、アモルファスワイヤ41は長さ約2mm、直径数十 $\mu$ mの軟磁性のアモルファス磁性体から構成されている。アモルファス磁性体は、例えば、FeB、CoB、FeNiSiB、FeCoSiB、CoSiBを用いることができ、検知コイルに誘起される検知信号の線形性の点より、印可される外部磁場が数Oe以下において磁歪を示さない材料或いは線引き後の材料が好ましい。なお、アモルファスワイヤ41に替えて軟磁性薄膜あるいは軟磁性薄体を使用することができるが、軟磁性薄膜あるいは軟磁性薄体の幅方向の反磁場がアモルファスワイヤ41より大きく、アモルファスワイヤ41の周回方向の反磁場は0なので、磁場検出感度の点でアモルファスワイヤ41がより好ましい。なお、アモルファスワイヤ41に替えて非磁性導体のワイヤを芯材として、その表面を軟磁性材料を10nmから5 $\mu$ mの厚さで、電着法、蒸着法、スパッタ法、CVD法などにより被覆したものをを用いても良い。この場合の軟磁性材料には上述した、FeB、CoB、FeNiSiB、FeCoSiB、CoSiBの他、NiFe（パーマロイ）、FeAlSi等の軟磁性材料を用いることができる。芯剤には例えばAl、Cu等を用いることができ、アモルファスワイヤを用いた場合より軟磁性材料の選択の範囲が拡大する点で好ましく、また、電極に接続し易い芯材が選択できる点で好ましい。

## 【0045】

また、アモルファスワイヤ41の長さを2mm以下、さらには1mm以下にしてもよい。磁気インピーダンス効果の原理により、アモルファスワイヤ41を短小化しても外部磁場の検出感度は悪化せず、小型化可能な点で好ましい。短小化した場合の問題点はアモルファスワイヤとAlなどからなる端子43とのボンディングがより困難になることであるが、超音波併用熱圧着法により可能である。また、アモルファスワイヤ41の周回方向に巻回される検知コイル42は、例えば10t～30tである。

## 【0046】

次に図3及び図4を参照しながら、本実施の形態のMIセンサ10用のICチップについて詳述する。



## 【0047】

図3は、本実施の形態のMIセンサの回路図である。また、図4(A)～(D)はその波形図である。図3を参照するに、本実施の形態のICチップ13は、パルス発生回路21と、バッファ回路23と、スイッチング回路24と、検出回路25と、増幅回路26と、出力回路28などにより構成されている。以下各回路について詳述する。

## 【0048】

パルス発生回路21では、200kHz～10数MHzのパルス状あるいは高周波の信号が生成される。具体的には、マルチバイブレータや水晶発振器を用いた発振回路等によりデューティ比約50%のパルス信号を発生させ、そのパルス信号を積分回路等により遅延させ、例えば、もとの信号と遅延させた信号の反転信号の「AND」をとって、図4(A)に示す例えば1～30nsの時間幅の短いパルスが生成される。本実施の形態ではパルス周期を500kHzとした。パルス発生回路21により生成されたパルス信号はバッファ回路23に送信される。

## 【0049】

バッファ回路23は、数個～10数個の直列に接続されたバッファより構成される。下流のバッファになるほど、より大きな駆動電流を流すことが可能なように、例えばCMOS-FETのゲート幅とゲート長の積を次第に大きく設定してもよい。スイッチング回路24の制御部により大きな電流を流すことができる。

## 【0050】

スイッチング回路24では、バッファ回路23により電流が増幅されたパルス信号が制御部に入力される。スイッチング回路24は例えばMOS-FETにより構成され、パルス信号がそのゲートに入力される。パルス信号によりこのMOS-FETがターンオンされると、励磁電流がソースから電極を介して電極に接続されたMI素子12に供給される。ここで励磁電流は、100mA～500mAの範囲であることが好ましい。100mAより小さいとMI素子12の検知コイル42に十分な出力電圧が誘起されず、信号対雑音比が低下、すなわち磁場検出感度が低下してしまう。また500mAより大きいとスイッチング時に発生し

たノイズが他の回路、例えば検出回路 25 の検知信号に重畳してしまい、信号対雑音比を低下させてしまう。

#### 【0051】

さらにスイッチング回路 24 の電源線は IC チップ 13 の表面に設けられている第 1 電源電極 18 A に接続され、他の回路、例えば検出回路 25 やバッファ回路 23 の電源線とは独立に設けられている。さらに、スイッチング回路 24 の接地線は、第 1 グランド電極 19 A に接続され、他の回路、例えば検出回路 25 やバッファ回路 23 の接地線とは独立に設けられ、互いに接続されていない。スイッチング回路 24 のスイッチング時に発生するノイズが電源線や接地線を伝導して検出回路 25 等に混入することを防止できる。なお、上記他の回路の電源線は IC チップ 13 の表面に設けられている第 2 電源電極 18 B に接続され、接地線は第 2 グランド電極 19 B に接続されている。なお、ここで第 1 及び第 2 電源電極 18 A、18 B には、IC チップ 13 の外部の電源が接続される。第 1 及び第 2 電源電極 18 A、18 B の各々に対して独立に電源が接続されていても良く、共通の電源が接続されていても良い。少なくとも IC チップ 13 内では電源線を独立に設けることにより、スイッチング回路 24 からのノイズが検出回路 25 等へ混入することを防止できる。

#### 【0052】

スイッチング回路 24 からの励磁電流は、IC チップ 13 の表面に形成された励磁電流用電極 16 (図 1 に示す) に取り出される。励磁電流用電極 16 は、スイッチング回路 24 に近くかつ MI 素子 12 に近い、例えば MI 素子 12 に面する IC チップ 13 の辺に近い程良い。励磁電流は比較的大電流であるので、スイッチング回路 24 から MI 素子 12 までの配線が長すぎると、配線がアンテナとなって電磁波を放射してしまい、信号対雑音比を低下させてしまう。

#### 【0053】

励磁電流用電極 16 にワイヤなどによって接続された MI 素子 12 には、パルス状の励磁電流が図 2 に示すアモルファスワイヤ 41 に流れ、IC チップ 13 のグランド電極 16 G に落とされる。さらに、グランド電極 16 G は上述した第 1 グランド電極 19 A に接続されている。したがって、他の回路、例えば検出回路

25やバッファ回路23へのノイズの影響を抑制することができる。なお、励磁電流はICチップ13のグランド電極16Gの替わりにICチップ13の外部、例えばMIセンサ10のケース11上の電極を介して、例えばMIセンサ10が実装されているプリント基板(PCB)のグランドに接続されてもよい。

#### 【0054】

MI素子12は、アモルファスワイヤ41に平行な外部磁場の成分の大きさに応じて、図4(C)に示すように検知コイル42の両端に検知信号が誘導される。この検知信号はワイヤ及びICチップ13の表面に形成された検知信号用電極17を介して検出回路25に供給される。

#### 【0055】

検出回路25は、ホールド回路32及び増幅器33などより構成されている。コンデンサなどにより構成されたホールド回路32により、図4(D)に示すように、検知信号のピーク値がホールドされる。なお、図4(D)中の点線は、図4(C)に示す検知信号を示す。次いで、増幅器33ではホールドされた信号を増幅し検出信号として出力される。

#### 【0056】

増幅回路26では、検出信号が所望の電圧まで増幅され、ICチップ13の表面に設けられた出力用電極20を介してICチップ13の外部、例えばMPU等に出される。また、増幅回路26にさらに出力回路28を設け、低インピーダンスの出力信号に変換されてもよい。また、A/Dコンバータによりデジタル信号として出力されもよい。なお、MIセンサ10が搭載された電子装置では、このICチップ13の出力信号から、磁場成分を抽出することにより、外部磁場の大きさを求めることができる。

#### 【0057】

次に、本願の特徴の一つであるICチップを構成する回路の配置について説明する。

#### 【0058】

図5は、本実施の形態のICチップの回路配置及びMI素子を示す平面図である。図5を参照するに、ICチップ13には、上述したパルス発生回路21、バ

ッファ回路 23、スイッチング回路 24、検出回路 25、増幅回路 26、出力回路 28、MI 素子 12 に励磁電流を供給する励磁電流用電極 16、励磁電流用グランド電極 16G、MI 素子 12 の検出コイルから検知信号が供給される検知信号用電極 17、IC チップに電源電圧を供給するための電源電極 18A、18B、グランド電極 19A、19B、及び検出信号を出力する出力用電極 20 が配置されている。この回路配置で特徴的なのは、MI 素子に接続される、励磁電流用電極 16、励磁電流用グランド電極 16G、及び検知信号用電極 17 が MI 素子に面する辺 AB の近傍に配置され、また、電源電圧を供給する電源電極 18A、18B 及び検出信号を MPU などに供給する出力用電極 20 は、MI 素子 12 に面する辺とは反対側の IC チップの辺 CD の近傍に設けられている。ここで、第 1 電源電極 18A はスイッチング回路 24 に接続され、第 2 電源電極 18B は他の回路、例えばルース発生回路 21、バッファ回路 23、スイッチング回路 24、検出回路 25、増幅回路 26、出力回路 28 等に接続されている。このように配置することにより、MI 素子 12 に供給される励磁電流から発生するノイズが第 2 電源電極 18B 及び第 2 電源電極 18B に接続される電源線を介して検出回路 25 等に混入することを防止でき、検出信号等に重畳することを防止できる。

#### 【0059】

また、さらにスイッチング回路 24 に電源電圧を供給する第 1 電源電極 18A と、スイッチング回路 24 と、励磁電流用電極 16 とをほぼ直線状に配置する。好ましくは例えば図 5 に示すように辺 AB 及び辺 CD に挟まれた辺 AD に沿って配置する。他の回路へのノイズ混入を防止すると共に、IC チップの面積効率を向上し、IC チップを小型化することができる。

#### 【0060】

さらに、スイッチング回路 24 と励磁電流を MI 素子 12 に供給する励磁電流用電極 16 は近接して配置される。スイッチング回路 24 から励磁電流用電極 16 までの配線長を可能限り短くし、配線からの電磁波の放射を抑制することができる。

#### 【0061】

また、励磁電流を MI 素子 12 に供給する IC チップ 13 の表面に形成された

励磁電流用電極 16 は、MI 素子 12 に面する辺 AB あるいはその付近に辺 AB に可能な限り近接して配置される。励磁電流用電極 16 から MI 素子 12 までの配線長を可能限り短くし、配線からの電磁波の放射を抑制することができる。

#### 【0062】

検知信号用電極 17 及び検出回路 25 も同様に、MI 素子 12 に面する辺 AB あるいはその付近に配置される。MI 素子 12 の検知信号にノイズが重畳されることを防止する。

#### 【0063】

以上、1 軸の MI 素子を備えた MI センサについて説明したが、2 軸の MI 素子を備えた MI センサについても、電源線及び接地線のアイソレーションを適用できる。

#### 【0064】

(第 2 の実施の形態)

図 6 は、本発明の実施の形態の 2 軸の MI 素子を備えた MI センサの斜視図である。図中、先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。

#### 【0065】

図 6 を参照するに、本実施の形態の MI センサ 40 は、ケース 11 と、同じ面内で互いに垂直 (X 軸と Y 軸とする。) をなしてケース 11 内に配設された 2 つの MI 素子 12<sub>X</sub>、12<sub>Y</sub> と、MI 素子 12<sub>X</sub>、12<sub>Y</sub> と接続され、ケース 11 内に配設された IC チップ 44 などにより構成されている。この MI センサ 40 は、IC チップ 44 から励磁電流が MI 素子 12<sub>X</sub>、12<sub>Y</sub> に供給され、磁気インピーダンス効果により外部磁場の大きさに対応した検知信号が X 軸及び Y 軸の MI 素子 12<sub>X</sub>、12<sub>Y</sub> に誘導され、IC チップ 44 によりその検知信号が処理され、X 軸及び Y 軸方向の外部磁場の大きさに対応した出力信号が出力される。MI センサ 40 は、X 軸及び Y 軸の外部磁場の大きさを検出することにより、外部磁場の方向を検出することができる。

#### 【0066】

図 7 は、図 6 に示す 2 軸の MI 素子を備えた MI センサ 40 の回路図である。

図7を参照するに、係るMIセンサのICチップ44は、パルス発生回路21と、XY軸切替スイッチ22と、バッファ回路23<sub>x</sub>、23<sub>y</sub>と、スイッチング回路24<sub>x</sub>、24<sub>y</sub>と、検出回路25と、増幅回路26と、出力回路28などにより構成されている。この2軸のMI素子用のICチップ44は、図3に示した1軸のMI素子用のICチップ13の回路を基本にして、励磁電流をX軸及びY軸のMI素子12<sub>x</sub>、12<sub>y</sub>に供給し、MI素子12<sub>x</sub>、12<sub>y</sub>に誘導された検知信号を検出するための回路を、X軸とY軸用の2回路としたものである。

#### 【0067】

そして、ICチップ44は、X軸及びY軸のMI素子12<sub>x</sub>、12<sub>y</sub>に励磁電流を流すための回路、すなわちバッファ回路23、スイッチング回路24、及び検出回路25のサンプリング回路31（後述する）はX軸、Y軸独立に、その他の回路はX軸、Y軸共通に構成されている。独立した回路部分は、MI素子12<sub>x</sub>、12<sub>y</sub>に十分な励磁電流を供給すると共に、互いに離隔して配置されているのでX軸用とY軸用の信号が互いに干渉してノイズが増大することを回避することができる。また、共通部分の回路、例えばパルス発生回路21、検出回路25などは、X軸用とY軸用の信号を共通に生成あるいは処理することにより、X軸用とY軸用の感度差等を低減することができ、また、回路数が低減されるのでICチップ44の小型化が可能となる。

#### 【0068】

以下、2軸のMI素子用のICチップ44について、1軸のMI素子用のICチップ13と異なる回路およびその動作について説明する。まず、パルス発生回路21により生成されたパルス信号はXY軸切替スイッチ22に供給され、ここでパルス信号が振り分けられる。XY軸切替スイッチ22では、具体的には外部からXY軸切替信号用電極27を介して供給されるXY軸切替信号により制御され、パルス信号がX軸若しくはY軸用のバッファ回路23<sub>x</sub>、23<sub>y</sub>に振り分けられる。なお、XY軸切替信号は、ICチップ44の外部、例えばMIセンサ10が実装された電子装置のMPU等から供給され、「Low」または「High」のデジタル信号である。例えば、XY軸切替信号が「High」のときはX軸用のバッファ回路23<sub>x</sub>、「Low」のときはY軸用のバッファ回路23<sub>y</sub>にパルス

信号が振り分けられるようになっている。

#### 【0069】

振り分けられたパルス信号はバッファ回路 2 3<sub>X</sub>、2 3<sub>Y</sub>を介してスイッチング回路 2 4<sub>X</sub>、2 4<sub>Y</sub>の制御部に供給される。スイッチング回路 2 4<sub>X</sub>、2 4<sub>Y</sub>では、パルス信号により MOS-FET がターンオンされると、励磁電流がソースから励磁電流用電極 1 6 を介して MI 素子 1 2<sub>X</sub>、1 2<sub>Y</sub>のアモルファスワイヤ 4 1<sub>X</sub>、4 1<sub>Y</sub>に供給される。ここで、パルス信号が XY 軸切替スイッチ 2 2 で割り振られているため、X 軸及び Y 軸用のアモルファスワイヤ 4 1<sub>X</sub>、4 1<sub>Y</sub>に同時に励磁電流が供給されることがない。したがって、スイッチング回路 2 4<sub>X</sub>、2 4<sub>Y</sub>のクロストークによる誤動作を防止することができる。

#### 【0070】

検出回路 2 5 では、X 軸及び Y 軸の検知コイル 4 2<sub>X</sub>、4 2<sub>Y</sub>に誘起された検知信号を、パルス信号に同期させたサンプリング回路 3 1 により、検知信号のメインピークをサンプリングしホールド回路により、そのピーク値を保持する。

#### 【0071】

サンプリング回路 3 1 は、アナログスイッチ SW<sub>X</sub>、SW<sub>Y</sub>により構成されている。X 軸及び Y 軸の検知コイル 4 2<sub>X</sub>、4 2<sub>Y</sub>の検知信号に対して、アナログスイッチ SW<sub>X</sub>、SW<sub>Y</sub>の制御部に入力され、パルス信号が「H」のとき、検知信号を透過する。検知信号はバッファ回路 2 3 及びスイッチング回路 2 4 などによりパルス信号に対して遅れが生じているので、パルス信号を遅延回路 3 0 により遅延させ、検知信号の立上がりと同期させる。このような構成により、検知信号のメインピークを透過させることができる。

#### 【0072】

ホールド回路 3 2 により保持されたピーク値は、1 軸用の IC チップの回路と同様に、増幅回路 2 6 及び出力回路 2 8 を介して外部に出力される。

#### 【0073】

2 軸の MI 素子を備えた MI センサ用の IC チップ 4 4 の特徴的な点は、スイッチング回路 2 4<sub>X</sub>、2 4<sub>Y</sub>の電源線及び接地線が IC チップ 4 4 の他の回路、例えば検出回路 2 5 の電源線及び接地線に対して独立して設けられ、互いに接続さ

れていない点である。上述した1軸のMI素子を備えたMIセンサ用のICチップ13と同様に、スイッチング回路24によりスイッチング時に発生するノイズが電源線や接地線を伝導して検出回路25等に混入することを防止できる。

#### 【0074】

(第3の実施の形態)

図8は、本発明の実施の形態の携帯電話機の一例を示す分解図である。図9は、図8に示す携帯電話機の要部拡大図である。図8及び図9を参照するに、携帯電話機50は、表示部51と、操作部52と、アンテナ53と、スピーカ54と、マイク55と、通信用基板56と、通信用基板56に搭載されたMIセンサ58などより構成されている。

#### 【0075】

MIセンサ58は、上述した実施の形態の構成を有する。ここでは2軸用のMIセンサ58<sub>XY</sub>と1軸用のMIセンサ58<sub>Z</sub>を用いている。2軸用のMIセンサ58<sub>XY</sub>は、2軸用のICチップ59<sub>XY</sub>と2つのMI素子60<sub>X</sub>、60<sub>Y</sub>により構成され、一方、1軸用のMIセンサ58<sub>Z</sub>は、1軸用のICチップ59<sub>Z</sub>とMI素子60<sub>Z</sub>より構成され、MI素子60<sub>Z</sub>がICチップ59<sub>Z</sub>より分離されて通信用基板56の凹部に嵌合されて配置されている。通信用基板56を収納するスペース、特に厚さ方向のスペースが制限されているためである。

#### 【0076】

2軸用のMIセンサ58<sub>XY</sub>により通信用基板56の面内の2方向(X軸及びY軸方向とする。)の磁場を検出し、1軸用のMIセンサ58<sub>Z</sub>により通信用基板に垂直方向つまりZ軸方向の磁場を検出する。これらのMIセンサ58<sub>XY</sub>、58<sub>Z</sub>により、地磁気の方角に基づいて携帯電話機50の向いている方位・角度を検出することが可能である。特に、携帯電話機50を鉛直に立てた状態ではほぼ真北あるいは真南を向けた場合、すなわちZ軸をほぼ真北あるいは真南を向けた場合は、X軸及びY軸の磁場はほぼ0となるがZ軸のMIセンサにより携帯電話機50の向いている方位・角度を正確に検出することが可能である。

#### 【0077】

このようにして、携帯電話機50が受信し表示部51に表示された現在地付近



の地図を、M I センサにより検出された携帯電話機 5 0 の向いている方位・角度にあわせて、見やすいように表示部 5 1 上で回転させることができる。

#### 【0 0 7 8】

なお、2 軸及び 1 軸用の M I センサにより 3 軸を構成したが、1 軸用の M I センサを 3 個配置して 3 軸と構成してもよい。

#### 【0 0 7 9】

上述したように、本実施の形態の M I センサ 5 8 は M I 素子 6 0 X ~ 6 0 Z を I C チップ 5 9 X Y、5 9 Z により駆動し、外部磁場を検出する。したがって、従来のディスクリートの回路によって構成されている M I センサより小型化可能である。なお、携帯電話機 5 0 の通信機能を有する基本構成自体は周知であり、その詳細な説明は本明細書では省略する。

#### 【0 0 8 0】

なお、本実施の形態の電子装置を携帯電話機を一例として説明したが、携帯電話機に限定されるわけではない。例えば、携帯端末機、カーナビゲーション装置等に適用できる。

#### 【0 0 8 1】

以上本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。

#### 【0 0 8 2】

##### 【発明の効果】

以上詳述したところから明らかなように、本発明によれば、小型化が可能でかつ高感度な M I センサ、M I センサ用の I C チップおよびその M I センサを備えた電子装置を提供することができる。

##### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

本発明の第 1 の実施の形態の M I センサの斜視図である。

##### 【図 2】

第 1 の実施の形態に係る M I 素子の一例を示す斜視図である。

## 【図 3】

第 1 の実施の形態に係る M I センサの回路図である。

## 【図 4】

(A) ～ (D) は図 3 に示す回路の波形図である。

## 【図 5】

第 1 の実施の形態の I C チップの回路配置及び M I 素子を示す平面図である。

## 【図 6】

本発明の第 2 の実施の形態の M I センサの斜視図である。

## 【図 7】

第 2 の実施の形態に係る M I センサの回路図である。

## 【図 8】

本発明の第 3 の実施の形態の携帯電話機の一例を示す分解図である。

## 【図 9】

図 8 に示す携帯電話機の要部拡大図である。

## 【符号の説明】

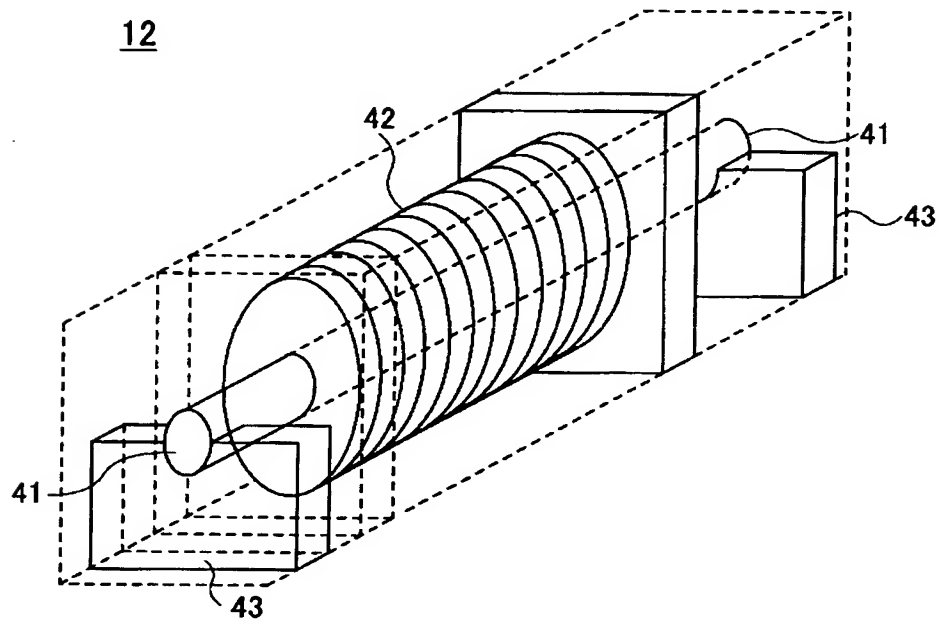
- 1 0、4 0、5 8、5 8<sub>XY</sub>、5 8<sub>Z</sub>     M I センサ
- 1 1     ケース
- 1 2、1 2<sub>X</sub>、1 2<sub>Y</sub>、6 0<sub>X</sub>、6 0<sub>Y</sub>、6 0<sub>Z</sub>     M I 素子
- 1 3、4 4、5 9<sub>XY</sub>、5 9<sub>Z</sub>     I C チップ
- 1 4     ケース電極
- 1 5     ワイヤ
- 1 6     励磁電流用电極
- 1 6 G     励磁電流用グランド電極
- 1 7     検知信号用电極
- 1 8 A     第 1 電源電極
- 1 8 B     第 2 電源電極
- 1 9 A     第 1 グランド電極
- 1 9 B     第 2 グランド電極
- 2 0     出力用电極

- 2 1      パルス発生回路
- 2 2      X Y 軸切替スイッチ
- 2 3、2 3<sub>X</sub>、2 3<sub>Y</sub>      バッファ回路
- 2 4、2 4<sub>X</sub>、2 4<sub>Y</sub>      スイッチング回路
- 2 5      検出回路
- 2 6      増幅回路
- 2 8      出力回路
- 3 1      サンプリング回路
- 4 1、4 1<sub>X</sub>、4 1<sub>Y</sub>      アモルファスワイヤ
- 4 2、4 2<sub>X</sub>、4 2<sub>Y</sub>      検知コイル
- 4 3      端子
- 5 0      携帯電話機



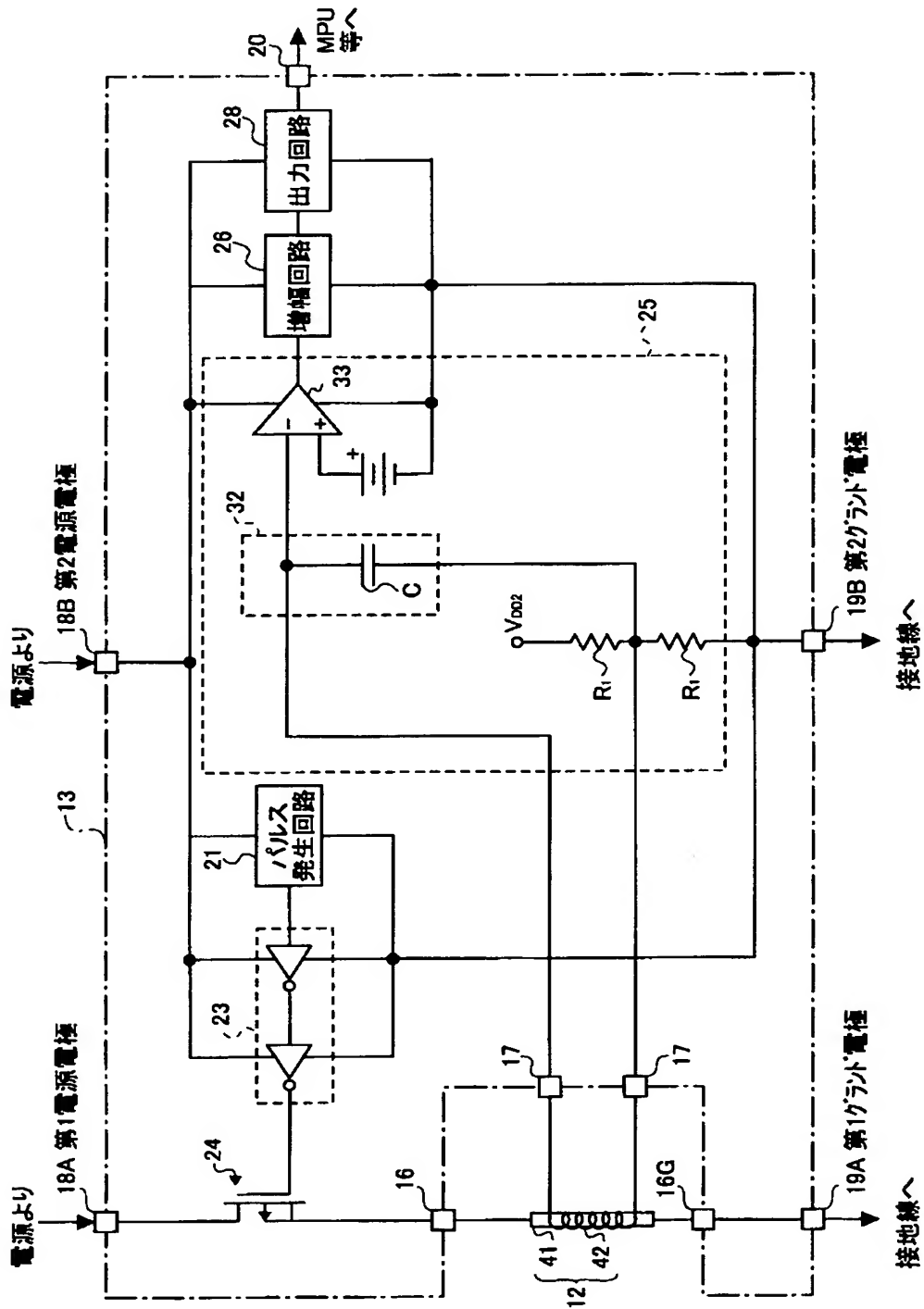
【図 2】

第 1 の実施の形態に係る M I 素子の一例を示す斜視図



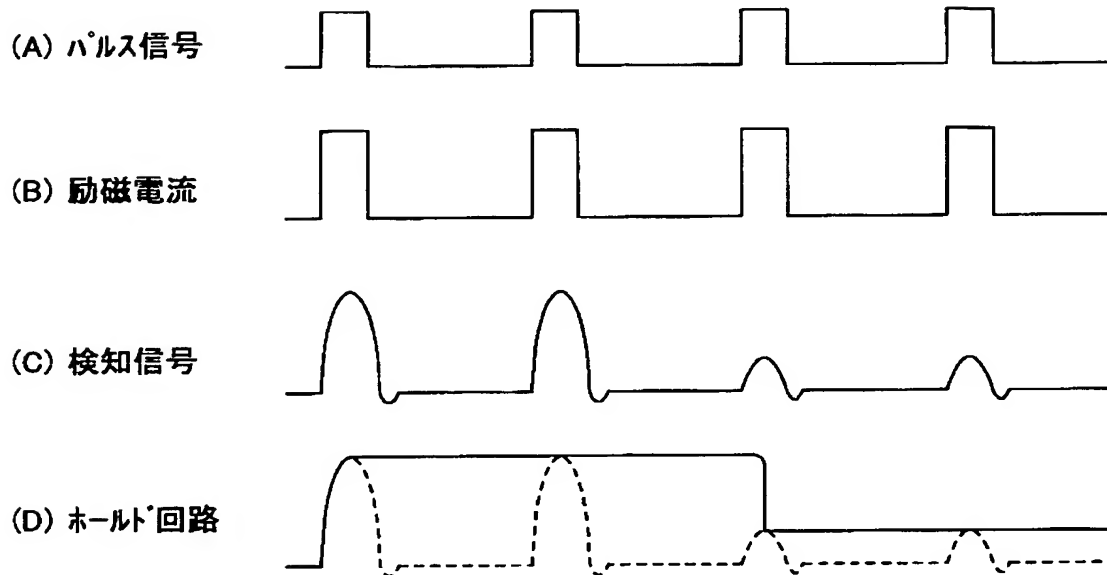
【図3】

第1の実施の形態に係るMIセンサの回路図



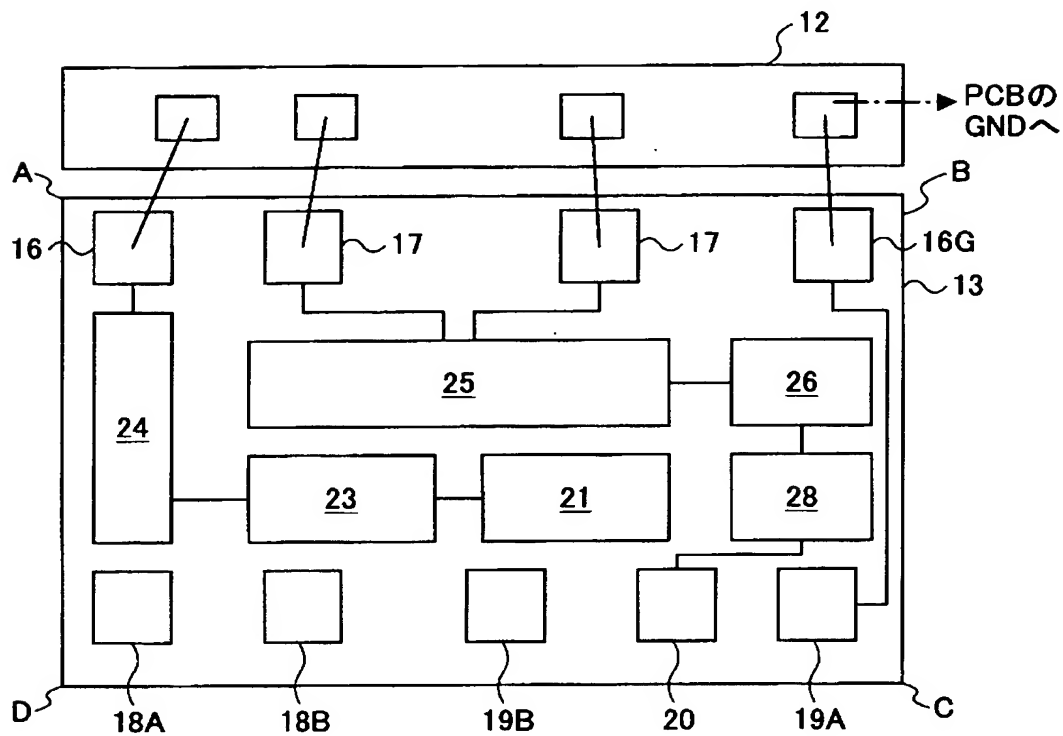
【図 4】

(A) ~ (D) は図 3 に示す回路の波形図



【図 5】

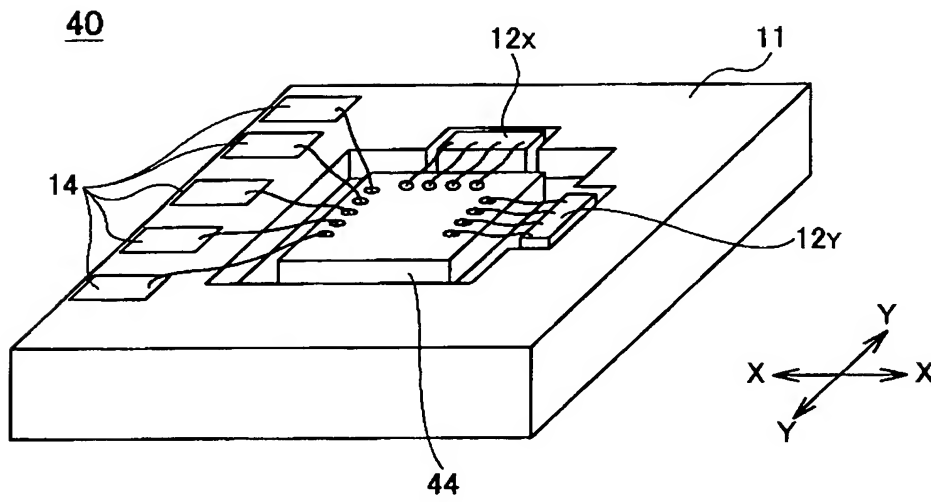
第1の実施の形態のICチップの回路配置及びM1素子を示す平面図





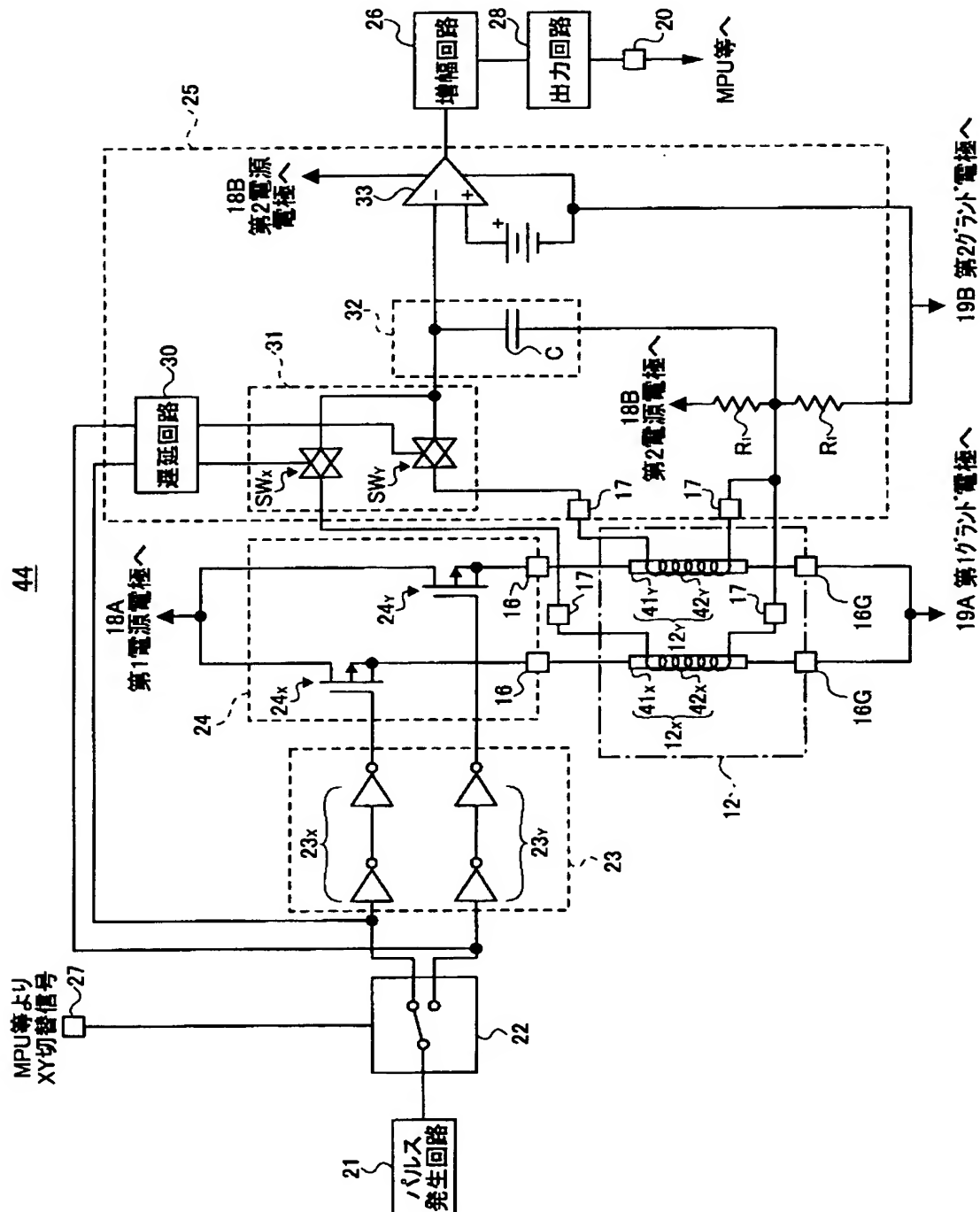
【図 6】

本発明の第 2 の実施の形態の M I センサの斜視図



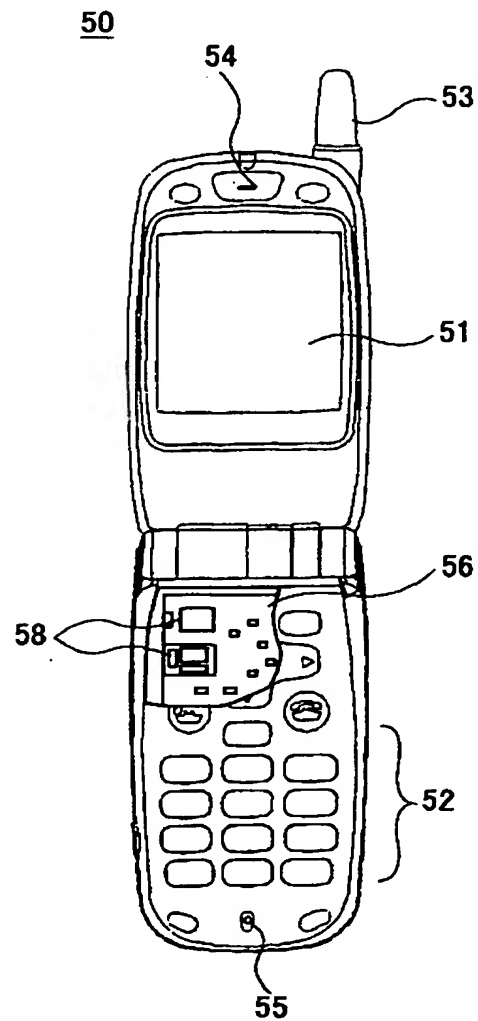
【圖 7】

## 第2の実施の形態に係るM I センサの回路図



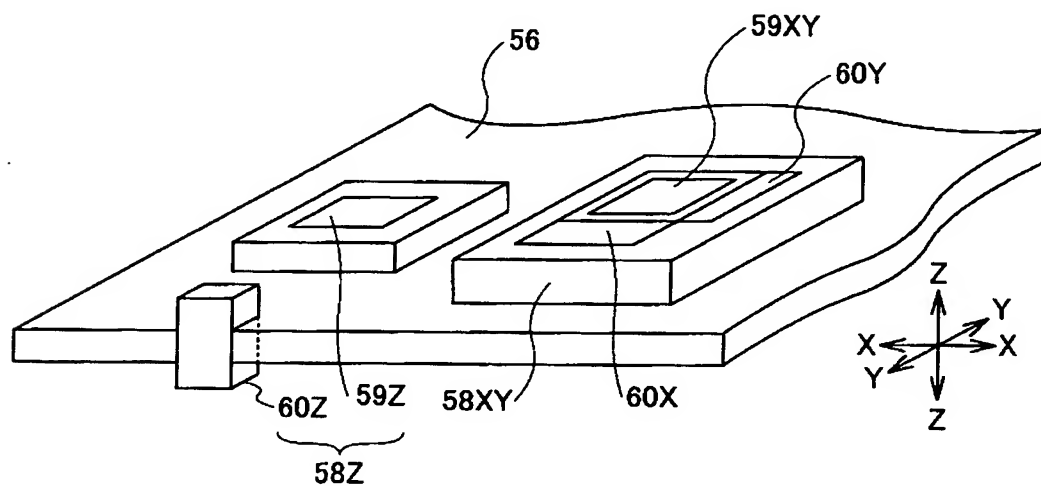
【図 8】

本発明の第 3 の実施の形態の携帯電話機の一例を示す分解図



【図 9】

図 8 に示す携帯電話機の要部拡大図



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 小型化が可能でかつ高感度なM I センサ、M I センサ用の I C チップおよびそのM I センサを備えた電子装置を提供する。

【解決手段】 1 軸のM I 素子 1 2 が接続されるM I センサ用の I C チップ 1 3 において、M I 素子 1 2 に接続される励磁電流用電極 1 6 をM I 素子 1 2 に面する I C チップの辺 A B の近傍に配置し、スイッチング回路 2 4 に電源電圧を供給する電源電極 1 8 A をその辺と対向する辺 C D の近傍に配置する。さらにスイッチング回路 2 4 を励磁電流用電極 1 6 の近傍に配置しても良い。

【選択図】 図 5

特願 2 0 0 2 - 3 1 8 2 4 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 6 7 4 7 ]

1. 変更年月日            1 9 9 0 年    8 月 2 4 日  
    [変更理由]            新規登録  
          住    所        東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号  
          氏    名        株式会社リコー
  
2. 変更年月日            2 0 0 2 年    5 月 1 7 日  
    [変更理由]            住所変更  
          住    所        東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号  
          氏    名        株式会社リコー